中国集成电路封测行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chinabaogao.com/baogao/202611/824454.html

报告价格：电子版: 8200元　纸介版：8200元　电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

集成电路封测即集成电路的封装与测试，是集成电路产业链中不可或缺的后道工序，位于IC设计与IC制造之后，最终IC产品之前，对保护芯片、实现芯片与外部电路的连接以及确保芯片性能和质量等都有着至关重要的作用。

1、我国集成电路封测行业相关标准

2026年我国集成电路封测行业标准体系持续完善，多项标准覆盖封装术语、芯粒互联、先进封装设计及引线框架等细分领域，均为规范类标准。其中，GB/T 14113—2026《半导体集成电路封装术语》全面替代1993版，统一封装、互连与先进封装基础词汇；GB/T46280.1—2025《芯粒互联接口规范》系列初步建立我国芯粒互联接口标准体系，为Chiplet跨厂商互联互通提供统一技术基础；SJ/T 12076-2025《硅基光电子芯片封装设计导则》为光电共封等硅光封装路线提供设计依据；《集成电路蚀刻型引线框架》行业标准填补细分领域空白。此外，SJ/T 12438—2026《集成电路电子设计自动化工具封装基板工艺文件格式》已列入行业标准制修订计划，旨在打通封装设计与基板制造的数据格式衔接。

我国集成电路封测行业部分相关标准 发布时间 发布部门 标准名称 相关内容 政策性质

2026年11月10日发布，2027年5月1日实施 工业和信息化部办公厅（SJ/T 计划） SJ/T 12438—2026《集成电路电子设计自动化工具封装基板工艺文件格式》 列入2026年第四批行业标准制修订项目计划，由SAC/TC599负责管理，同批还包括人工智能芯片面向芯粒的卡间互联接口测试方法等；旨在打通封装设计与基板制造的数据格式衔接，目前处于起草阶段、尚未发布。 规范类

2026-09-28发布，2027-04-01实施 市场监管总局、国家标准化管理委员会（GB/T） GB/T 14113-2026《半导体集成电路封装术语》由全国集成电路标准化技术委员会（SAC/TC599）归口、工业和信息化部（电子）主管，全部代替GB/T14113-1993。长电科技、中国电科十三所、中国电子技术标准化研究院等参与起草，统一封装、互连与先进封装基础词汇，解决产业链术语歧义。 规范类

2026-08-28发布，2027-03-01实施 市场监管总局、国家标准化管理委员会（GB/T） GB/T 15879.616-2026《半导体器件的机械标准化

第6-16部分：BGA、LGA、FBGA和FLGA的半导体试验和老化插座术语表》修改采用ISO/IEC国际标准，统一球栅阵列、焊盘阵列及密节距封装在试验与老化插座环节的术语口径，主管部门与归口部门均为工业和信息化部（电子）。 规范类

2025-12-19发布，2026-07-01实施 工业和信息化部（SJ/T） SJ/T 12076-2025《硅基光电子芯片封装设计导则》 行业标准、推荐性、现行。规定硅基光电子芯片封装设计的技术要求与导则，备案号106831-2026，备案公告2026年第7号，为光电共封（CPO）等硅光封装路线提供设计依据。 规范类 2025年9月9日发布，2026-03-01实施

工业和信息化部（SJ/T） 《集成电路蚀刻型引线框架》电子行业标准 由宁波本地企业与宁波市标准化研究院等联合起草，填补细分领域空白。适用于裸铜、铜镀银、铜镀镍钯金等材质的蚀刻型引线框架，覆盖主流封装类型，从原材料、外观、尺寸公差、电镀工艺多维度设技术要求，并配套出厂检验与型式检验规则。 规范类 2025-08-19发布，2026-03-01实施 市场监管总局、国家标准化管理委员会（GB/T） GB/T46280.1—2025《芯粒互联接口规范》系列（总则、协议层、数据链路层、基于2D封装的物理层、基于2.5D封装的物理层） 五项推荐性国家标准，初步建立我国芯粒互联接口标准体系，为Chiplet产品跨厂商互联互通提供统一技术基础；第6部分“基于3D封装的物理层技术要求”尚在征求意见阶段，尚未发布。 规范类

资料来源：公开文件、观研天下整理

2、我国国家层面集成电路封测行业相关政策

为扩大集成电路封测行业的应用等，我国陆续发布了多项政策，如2026年9月10日工业和信息化部、国家发展改革委发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》，在“筑牢产业基础能力”部分提出推动集成电路全链条攻关，明确“推动先进封装测试技术开发和应用”，并围绕载板大尺寸、三维立体集成、异质异构集成、微缩等方向开展生产设备研发，同时提出推进三维集成技术突破和应用、健全智能传感器设计制造封测全流程质量管控机制。

我国集成电路封测行业部分相关政策情况 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 政策性质 2026-09-29 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局 《关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知》（工信部联电子函〔2026〕326号） 依据财税〔2023〕17号，清单覆盖集成电路设计、生产、封测、装备、材料五类企业，按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。申报窗口2026-10-09至10-16，省级部门10-31前报送，11-30后企业可查询结果；列入者自2026-01-01起享受，在2025年清单但未列入2026年清单者于2026-11-30停享。 支持类 2026-09-10 工业和信息化部、国家发展改革委 《电子信息制造业发展“十五五”规划》（工信部联规〔2026〕216号） 在“筑牢产业基础能力”部分提出推动集成电路全链条攻关，明确“推动先进封装测试技术开发和应用”，并围绕载板大尺寸、三维立体集成、异质异构集成、微缩等方向开展生产设备研发，同时提出推进三维集成技术突破和应用、健全智能传感器设计制造封测全流程质量管控机制。 支持类 2026-08-17 市场监管总局（国家认监委） 《汽车芯片机构认证审查通用评价要求》等五项认证认可行业标准（2026年第15号公告） 全球首个针对汽车芯片全产业链相关机构的国家层面能力评价标准体系，形成“1+4”架构，把监管重心从“评价芯片产品”转向“评价检测机构能力”，解决同一颗芯片被不同车企重复做AEC-Q系列可靠性测试、报告互不采信的问题，缩短车规芯片上车周期。 规范类 2026-04-07 国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局 《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》（发改

高技〔2026〕487号） 在财关税〔2021〕4号框架下，明确“先进封装测试企业”与逻辑电路、存储器、特色工艺、化合物集成电路生产企业并列列入清单，可享进口自用设备及随设备进口技术、配套件、备件免征进口关税；同时衔接所得税优惠。申报窗口2026-04-07至04-19，须经省级发改或工信部门初核后报国家联审。 支持类

资料来源：政府部门公开政策文件、观研天下整理

3、我国地方层面各省市集成电路封测行业相关政策

我国各省市也积极响应国家政策规划,对各省市集成电路封测行业的发展做出了具体规划,支持当地集成电路封测行业稳定发展，比如2026年7月27日上海市人民政府办公厅发布《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》，提出三大先导产业制造业年均增速超10%，集成电路按全链突围、集群进阶推进；配套《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》明确聚焦张江、临港、嘉定建设“一体两翼”世界级集群，提高制造水平和封装能力，加快先进封装技术产业化。

我国部分省市集成电路封测行业相关政策 时间 发布部门 政策名称 相关内容 政策性质 2026-10-12 安徽省工业和信息化厅、安徽省发展和改革委员会 《关于组织开展2026年度集成电路企业增值税加计抵减申报工作的通知》 按工信部联电子函〔2026〕326号组织省内封测等企业申报：10月9日至16日在线填报并生成纸质件，10月16日前报电子版、10月20日前报纸质佐证材料至省工信厅，由省级初核汇总后推荐，落实地方日常监管责任。 规范类 2026-09-03 南通市工业和信息化局 《对市政协十三届五次会议第0383号提案的答复（关于打造“芯片之城”促进南通集成电路产业发展的建议）》 明确依托通富微电等链主企业做强封测优势，补齐数字芯片设计、晶圆制造短板，拓展汽车电子应用场景；深化“揭榜挂帅”机制支持龙头企业组建创新联合体攻关高端芯片与先进封装技术，并将集成电路纳入全市“十五五”规划、组建跨部门协调体系。 支持类 2026-07-27 上海市人民政府办公厅 《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》（沪府办发〔2026〕19号） 提出三大先导产业制造业年均增速超10%，集成电路按全链突围、集群进阶推进；配套《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》明确聚焦张江、临港、嘉定建设“一体两翼”世界级集群，提高制造水平和封装能力，加快先进封装技术产业化。 支持类 2026-05-8 北京市经济和信息化局（依据财政部等2020年第45号、2023年第44号公告） 《关于2026年北京市集成电路和软件企业享受税收优惠政策有关事项的通知》 明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业自获利年度起“两免三减半”征收企业所得税；封测企业研发费用未形成无形资产的按实际发生额120%税前扣除，形成无形资产的按成本220%税前摊销。申报须提交无严重失信、无重大安全质量事故及无严重环境违法声明。 支持类 2026-04-28 江苏省科学技术厅 《2026年度省科技重大专项项目指南》 将集成电路列入八大重点攻关领域，与年度670个省重大项目、6646亿元计划投资形成配套；封测侧落地项目包括扬州扬杰科技晶圆级芯片封装及车规级功率模块项目、无锡盛合晶微多层细线

宽系统集成封测项目（围绕RDL与2.5D/3D多芯片集成，列为2026年省重大项目）。
支持类 2026-04-09 深圳市发展和改革委员会 《关于组织申报2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知》 按发改高技〔2026〕487号组织本市企业申报，明确先进封装测试企业属清单范围；2025年已列入清单企业2026年须重新申报，截止后系统不再支持补充经审计会计报告；材料报市发展改革委，涉违法信息记入信用记录并在“信用中国”公示。 规范类 2025-12-30 上海市人民政府 《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》 在“加快先导产业战略引领”中明确支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装实现全产业链突破；对符合首台（套）重大技术装备、首批次新材料条件的，按不超过产品销售合同金额30%给予支持，单家最高2000万元。 支持类
资料来源：政府部门公开政策文件、观研天下整理
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
· 关于行业报告
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。
· 报告内容涵盖
观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。
· 报告数据来源
报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。
我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）
报告主要图表介绍
图（部分）
表（部分）
2021-2025年行业市场规模
行业相关政策
2021-2025年行业产量

行业相关标准
2021-2025年行业销量
PEST模型分析结论
2025年行业成本结构情况
行业所属行业企业数量分析
2021-2025年行业平均价格走势
行业所属行业资产规模分析
2021-2025年行业毛利率走势
行业所属行业流动资产分析
2021-2025年行业细分市场1市场规模
行业所属行业销售规模分析
2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测
行业所属行业负债规模分析
2021-2025年行业细分市场2市场规模
行业所属行业利润规模分析
2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测
所属行业产值分析
2021-2025年全球行业市场规模
所属行业盈利能力分析
2025年全球行业区域市场规模分布
所属行业偿债能力分析
2021-2025年亚洲行业市场规模
所属行业营运能力分析
2026-2033年亚洲行业市场规模预测
所属行业发展能力分析
2021-2025年北美行业市场规模
企业1营业收入构成情况
2026-2033年北美行业市场规模预测
企业1主要经济指标分析
2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测
企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测
企业1成长能力分析
2025年行业区域市场规模占比
企业2营业收入构成情况
2021-2025年华东地区行业市场规模
企业2主要经济指标分析
2026-2033年华东地区行业市场规模预测
企业2盈利能力分析
2021-2025年华中地区行业市场规模
企业2偿债能力分析
2026-2033年华中地区行业市场规模预测
企业2运营能力分析
2021-2025年华南地区行业市场规模
企业2成长能力分析
2026-2033年华南地区行业市场规模预测
企业3营业收入构成情况
2021-2025年华北地区行业市场规模
企业3主要经济指标分析
2026-2033年华北地区行业市场规模预测
企业3盈利能力分析
2021-2025年东北地区行业市场规模
企业3偿债能力分析
2026-2033年东北地区行业市场规模预测
企业3运营能力分析
2021-2025年西南地区行业市场规模
企业3成长能力分析
2026-2033年西南地区行业市场规模预测
企业4营业收入构成情况
2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测

企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况
……
……
图表数量合计
130+
· 关于我们
观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】
第一章 集成电路封测
第一节 集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测

三、集成电路封测
四、集成电路封测
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
第二节 中国集成电路封测
第三节 中国集成电路封测
第二章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国集成电路封测
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对集成电路封测
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章中国集成电路封测
第一节 中国宏观经济发展现状
第二节 中国对外贸易环境与影响分析
第三节 中国集成电路封测
一、PEST模型概述
二、政策环境影响分析
三、经济环境影响分析
四、社会环境影响分析
五、技术环境影响分析
第四节 中国集成电路封测
第四章 全球集成电路封测
第一节 全球集成电路封测
第二节 全球集成电路封测
一、2021-2025年全球集成电路封测
二、全球集成电路封测
第三节 亚洲集成电路封测
一、亚洲集成电路封测
二、2021-2025年亚洲集成电路封测
三、亚洲集成电路封测

第四节 北美集成电路封测
一、北美集成电路封测
二、2021-2025年北美集成电路封测
三、北美集成电路封测
第五节 欧洲集成电路封测
一、欧洲集成电路封测
二、2021-2025年欧洲集成电路封测
三、欧洲集成电路封测
第六节 2026-2033年全球集成电路封测
第七节 2026-2033年全球集成电路封测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测
第二节 中国集成电路封测
一、影响中国集成电路封测
二、2021-2025年中国集成电路封测
三、中国集成电路封测
第三节 中国集成电路封测
一、2021-2025年中国集成电路封测
二、中国集成电路封测
第四节 中国集成电路封测
一、2021-2025年中国集成电路封测
二、中国集成电路封测
第五节 中国集成电路封测
第六章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
第二节集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测
三、2021-2025年中国集成电路封测
第三节集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测

第四节 中国集成电路封测
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第五节 中国集成电路封测
第七章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、集成电路封测
第二节 中国集成电路封测
一、上游产业发展现状
二、上游产业对集成电路封测
三、下游产业发展现状
四、下游产业对集成电路封测
第三节 中国集成电路封测
一、中国集成电路封测
二、细分市场分析——市场1
1、2021-2025年市场规模与现状分析
2、2026-2033年市场规模与增速预测
三、细分市场分析——市场2
1、2021-2025年市场规模与现状分析
2、2026-2033年市场规模与增速预测
（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）
第八章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、中国集成电路封测
二、中国集成电路封测
第二节 中国集成电路封测
一、中国集成电路封测
二、中国集成电路封测
第三节 中国集成电路封测
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征
第四节 中国集成电路封测
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第九章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国集成电路封测
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国集成电路封测
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、影响集成电路封测
二、中国集成电路封测
第二节 中国华东地区集成电路封测
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区集成电路封测
1、2021-2025年华东地区集成电路封测
2、华东地区集成电路封测
3、2026-2033年华东地区集成电路封测

第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区集成电路封测
1、2021-2025年华中地区集成电路封测
2、华中地区集成电路封测
3、2026-2033年华中地区集成电路封测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区集成电路封测
1、2021-2025年华南地区集成电路封测
2、华南地区集成电路封测
3、2026-2033年华南地区集成电路封测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区集成电路封测
1、2021-2025年华北地区集成电路封测
2、华北地区集成电路封测
3、2026-2033年华北地区集成电路封测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区集成电路封测
1、2021-2025年东北地区集成电路封测
2、东北地区集成电路封测
3、2026-2033年东北地区集成电路封测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区集成电路封测
1、2021-2025年西南地区集成电路封测
2、西南地区集成电路封测
3、2026-2033年西南地区集成电路封测

第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区集成电路封测
1、2021-2025年西北地区集成电路封测
2、西北地区集成电路封测
3、2026-2033年西北地区集成电路封测
第九节 2026-2033年中国集成电路封测
第十一章集成电路封测
第一节 企业1
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业2
第三节 企业3
第四节 企业4
第五节 企业5
第六节 企业6
第七节 企业7
第八节 企业8
第九节 企业9
第十节 企业10
【第四部分 行业趋势、总结与策略】
第十二章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
第二节 2026-2033年中国集成电路封测
第三节 2026-2033年中国集成电路封测
一、2026-2033年中国集成电路封测
二、2026-2033年中国集成电路封测

三、2026-2033年中国集成电路封测
第四节 2026-2033年中国集成电路封测
一、2026-2033年中国集成电路封测
二、2026-2033年中国集成电路封测
第五节 2026-2033年中国集成电路封测
第六节 2026-2033年中国集成电路封测
第十三章 中国集成电路封测
第一节 观研天下中国集成电路封测
一、未来集成电路封测
二、未来集成电路封测
第二节 中国集成电路封测
第三节 中国集成电路封测
一、SWOT模型概述
二、行业优势
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国集成电路封测
第四节 中国集成电路封测
第五节 中国集成电路封测
第六节 观研天下中国集成电路封测
第十四章 中国集成电路封测
第一节 中国集成电路封测
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第二节 中国集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测
三、集成电路封测
四、集成电路封测
五、集成电路封测
第三节集成电路封测
一、集成电路封测
二、集成电路封测

三、集成电路封测
四、集成电路封测
第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：https://www.chinabaogao.com/baogao/202611/824454.html